

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2026-032

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

● 宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6 月 12 日、6 月 15 日、6 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。根据中证指数网截至 2026 年 6 月 15 日最新数据，公司所属中上协行业分类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最新市盈率为 72.02 倍，滚动市盈率为 65.69 倍；公司最新市盈率为 201.37 倍，滚动市盈率为 145.18 倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。公司股票价格短期快速上涨且累计涨幅较大，严重偏离大盘指数及同行业上市公司估值水平；最近 30 个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

● 近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。

● 公司覆铜板产品主要为 FR-4 及复合板等常规产品，目前无 AI 覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，未有高速覆铜板 M7 和 M9 产品销售，无相关订单和营业收入。其中 M7 尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9 处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。

● 公司电子铜箔以 HTE 高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI 服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓铜箔 HVLP1-3

目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI 服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4 处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00 万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。

● **经营业绩波动及产品迭代风险。**公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025 年度亏损，账面净利润-1,850.99 万元，该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；同时，若公司技术创新及产品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。

#### 一、股票交易异常波动的情况介绍

宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3 个交易日（2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

#### 二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：

- 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
- 6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险

之外，公司不存在其他重大风险事项；

7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

### 四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；

3、公司覆铜板产品主要为 FR-4 及复合板等常规产品，目前无 AI 覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，未有高速覆铜板 M7 和 M9 产品销售，无相关订单和营业收入。其中 M7 尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9 处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；

4、公司电子铜箔以 HTE 高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI 服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓铜箔 HVLP1-3 目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI 服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4 处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00 万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；

5、经营业绩波动及产品迭代风险。公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025 年度亏损，账面净利润-1,850.99 万元，该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；

同时，若公司技术创新及产品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。

6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

## 五、备查文件

- 1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
- 2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日